

明新科技大學 產學攜手計畫專案班 (封裝測試產業精英專班)
(109) 電子工程系 二技 全學程開課時序表

第一學年(109)					
科 目		第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必	※封裝能力鑑定(一)	3	3		
	※Tester設備操作與維修概論	3	3		
	※Handler設備操作與維修概論	3	3		
	※HF設備操作與維修概論	3	3		
	※積體電路工程	3	3		
	※半導體元件	3	3		
	※半導體製程技術			3	3
	※積體電路可靠性工程			3	3
	※Oven設備操作與維修概論			3	3
	※LD/UL設備操作與維修概論			3	3
	※治具設備操作與維修概論			3	3
	※封裝能力鑑定(二)			3	3
修					
小 計		18	18	18	18
選					
修					

第二學年(110)					
科 目		第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必	※測試能力鑑定(一)	3	3		
	※BIB治具設備操作與維修概論	3	3		
	※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3		
	※Lead Scanner原理與應用	3	3		
	※半導體製程實務	3	3		
	※實務專題(一)	3	3		
	※半導體產業分析			3	3
	※實務專題(二)			3	3
	※捲帶機原理與應用			3	3
	※打線機原理與應用			3	3
	※黏晶機設備操作與維修概論			3	3
	※測試能力鑑定(二)			3	3
修					
小 計		18	18	18	18
選					
修					

項 目	學分	時數
◎通識課程	0	0
▲專業基礎(院必修)	0	0
※專業必修	72	72
專業選修	0	0
合 計	72	72

備註：

- 1.最低畢業學分：__72__學分；必修學分：__72__學分
選修學分：__0__學分（選修學分含跨系選修學分）
- 2.表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。